

2018-2024年中国半导体用 环氧塑封料(EMC) 行业深度研究与投资前景预测报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制
www.chinairr.org

一、报告报价

《2018-2024年中国半导体用环氧塑封料(EMC) 行业深度研究与投资前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R02/R0201/201802/28-253756.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第一章 环氧塑封料产品概述

- 1.1 环氧塑封料产品定义
- 1.2 环氧塑封料的发展历程与产业现况
- 1.3 环氧塑封料技术发展趋势
- 1.4 环氧塑封料在半导体产业中的重要地位

第二章 环氧塑封料的组成、品种分类及生产过程

- 2.1 环氧塑封料产品组成
- 2.2 环氧塑封料产品品种分类
 - 2.2.1 以分立器件封装和集成电路封装两类分类
 - 2.2.2 以EMC所采用的环氧树脂体系分类
 - 2.2.3 以芯片封装外形以及具体应用分类
 - 2.2.4 以EMC的不同性能分类
- 2.3 环氧塑封料制作过程
- 2.4 环氧塑封料产品性能
 - 2.4.1 未固化物理性能
 - 2.4.2 固化物理性能
 - 2.4.3 机械性能
- 2.5 几种典型牌号环氧塑封料的品位和特性

第三章 环氧塑封料的应用及其主要市场领域

- 3.1 IC封装的塑封成形工艺过程
 - 3.1.1 IC封装塑封成形的工艺过程
 - 3.1.2 IC封装塑封成形的工艺要点
 - 3.1.3 IC封装塑封成形的质量保证
- 3.2 环氧塑封料的应用领域
 - 3.2.1 分立器件封装
 - 3.2.2 集成电路封装

第四章 全球半导体封测产业概况及市场分析

4.1 世界半导体封装业发展特点

4.2 世界半导体封装产品的主要生产制造商

4.3 世界半导体封装业的发展现状

4.3.1 2016年世界半导体产业与市场概况

4.3.2 世界封测产业与市场概况

4.4 世界封测产业的发展总趋势

4.5 世界封测产值统计

第五章 我国半导体封测产业概况及市场分析

5.1 2016年我国半导体产业发展状况

5.2 我国集成电路封测业发展现状

5.2.1 我国集成电路产业发展

5.2.2 我国集成电路封测产业发展现状

5.2.2.1 我国IC封测产业市场规模现状

5.2.2.2 我国IC封测厂家分布及产能

5.2.2.3 我国IC封测业的骨干生产企业情况

5.2.2.4 我国IC封测业内资企业在近期的技术发展

5.3 我国半导体分立器件封测业发展现状

5.3.1 我国半导体分立器件生产现状

5.3.2 我国半导体分立器件行业发展特点

5.3.3 我国半导体分立器件产业地区分布及市场结构

5.3.4 我国半导体分立器件生产厂家情况

5.3.5 我国半导体分立器件市场发展前景

第六章 世界环氧塑封料产业的生产与技术现状

6.1 世界环氧塑封料生产与市场总况

6.2 世界环氧塑封料主要生产企业概述

6.3 日本环氧塑封料生产厂家现状

6.3.1 住友电木（Sumitomo Bakelite）

6.3.2 日东电工（Nitto Denko）

6.3.3 日立化成（Hitachi Chemical）

6.3.4 松下电工株式会社 (Matsushita Electric)

6.3.5 信越化学工业 (Shin-Etsu Chemical)

6.3.6 京瓷化学 (Kyocera Chemical)

6.4 台湾环氧塑封料生产厂家现状

6.4.1 长春人造树脂

6.4.2 台湾其它环氧塑封料生产厂家现状

6.5 韩国环氧塑封料生产厂家现状

6.5.1 韩国环氧塑封料生产厂家情况总述

6.5.2 三星集团第一毛织

6.5.3 韩国KCC

6.6 欧美塑封料生产厂家现状

6.6.1 汉高集团 (Hysol)

6.6.2 欧美其它环氧塑封料生产厂家现状

第七章 我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求

7.1 我国环氧塑封料业的发展现状

7.2 我国环氧塑封料业生产企业情况

7.3 我国环氧塑封料业技术水平现况

7.3.1 国内不同性质企业的EMC产品水平分析

7.3.2 国内不同性质企业的EMC技术与产品结构现况

7.3.3 国内不同性质企业在EMC产品与技术研发能力的现况

7.4 我国国内环氧塑封料的市场需求情况

7.5 未来几年我国环氧塑封料行业的发展趋势预测

7.6 我国环氧塑封料的主要生产厂家情况

7.6.1 汉高华威电子有限公司

7.6.2 长兴电子材料(昆山)有限公司

7.6.3 住友电木(苏州)有限公司

7.6.4 日立化成工业 (苏州) 有限公司

7.6.5 北京首科化微电子有限公司

7.6.6 佛山市亿通电子有限公司

7.6.7 浙江恒耀电子材料有限公司

7.6.8 江苏中鹏电子有限公司

- 7.6.9 江苏晶科电子材料有限公司
- 7.6.10 广州市华塑电子有限公司
- 7.5.11 松下电工（上海）电子材料有限公司
- 7.6.12 北京中新泰合电子材料科技有限公司
- 7.6.13 长春封塑料（常熟）有限公司
- 7.6.14 无锡创达电子有限公司
- 7.6.15 广东榕泰实业股份有限公司

第八章 环氧塑封料生产主要原材料及其需求(ZYWZY)

8.1 EMC用环氧树脂

- 8.1.1 EMC对环氧树脂原料的要求
- 8.1.2 世界及我国环氧树脂业发展现状
- 8.1.3 国内环氧树脂产业的原材料供应情况
 - 8.1.3.1 双酚A
 - 8.1.3.2 环氧氯丙烷（ECH）
- 8.1.4 绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况

8.2 EMC用硅微粉

- 8.2.1 EMC对硅微粉原料的要求
- 8.2.2 EMC用硅微粉产品概述
- 8.2.3 国外EMC用硅微粉产品生产的现况
 - 8.2.3.1 日本EMC用硅微粉的生产现况
 - 8.2.3.2 北美EMC用硅微粉的生产现况
 - 8.2.3.3 欧洲EMC用硅微粉的生产现况
- 8.2.4 国内EMC用硅微粉产品产品生产的现况

图表目录：

- 图1-1 为适应封装技术环氧树脂的开发动向
- 图1-2 集成电路封装制造过程及其塑封加工的重要作用
- 图1-3 EMC样品
- 图1-4 P-BGA封装的基本结构
- 图1-5 目前几种常见半导体封装形式及EMC在其中的应用
- 图1-6 2015年全球IC封装材料市场份额

图2-1 环氧塑封料的成分比及各种成分的效果

图2-2 EMC使用的主要环氧树脂分子结构

图2-3 半导体封装分类的具体产品形式

图2-4 环氧塑封料制造的主要工艺流程

图2-5 环氧塑封料的主要生产过程

图3-1 引线框架-陶瓷基板式IC封装的树脂塑封成形的工艺过程

图3-2 有机封装基板式IC封装树脂塑封成形的工艺过程

图3-3 注塑成形的模具构造

图4-1 半导体封装形式及技术的发展情况

图4-2 世界各类封装形式占比例 图4-3 2013-2015全球半导体市场规模和年增幅

图4-4 封测行业及封测外包行业市场规模

图4-5 全球半导体行业和封测外包行业市场年增长率(%)

图4-6 2012-2016年整合元件生产商和封测外包商的产值和年增长

图5-1 我国半导体产业销售额增长状况

图5-2 我国半导体产业销售额占国内、世界半导体市场的份额

图5-3 我国半导体市场需求增长状况

图5-4 2015年～2016年我国半导体产业销售额发展预测

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R02/R0201/201802/28-253756.html>